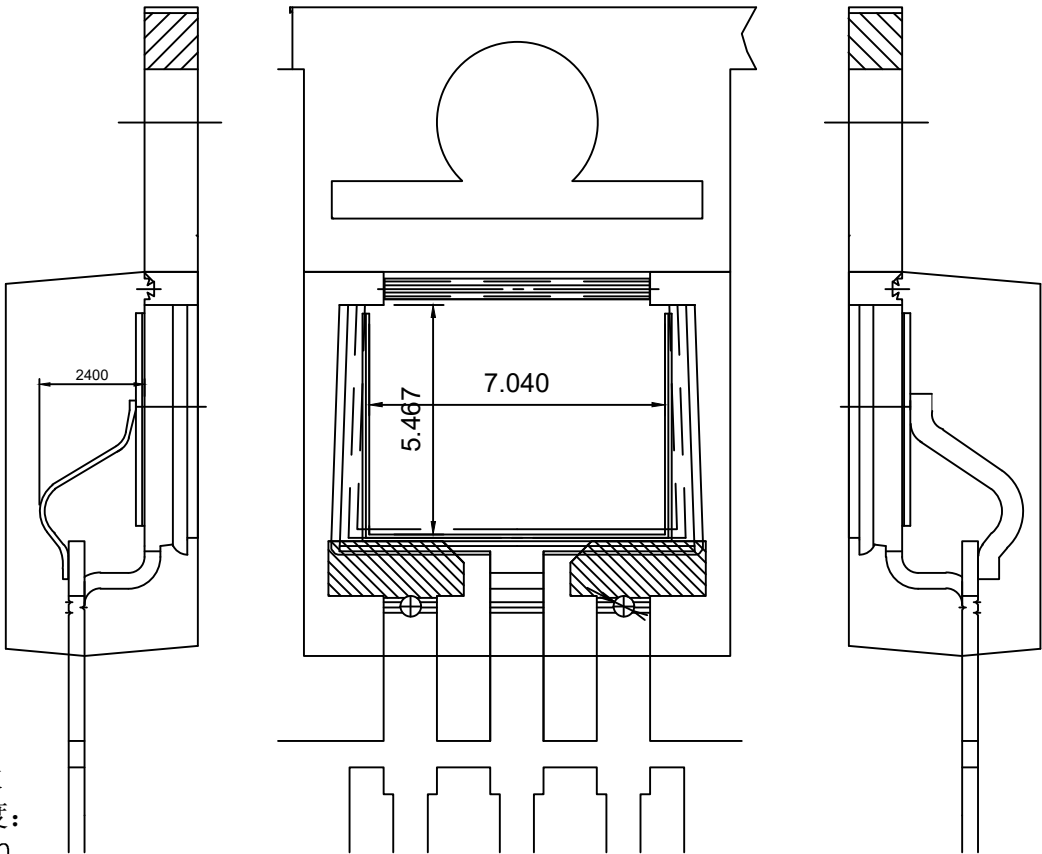




装片键合配线图

配线图号		版本号		封装外形	T0-263-3L
<div>装片方向</div> <div>引线框传输方向</div> <div></div>					客户回签



*特殊要求
线弧高度:
AL Ribbon
CU Wire ≤600μm
图纸坐标A, 坐标B公差±50μm

芯片信息				封装信息			
成品名称				装片方式		焊线方式	
芯片名称				框架型号		G极焊线	
芯片尺寸 (um)		芯片厚度 (um)		框架镀层		S极焊线	
G极尺寸 (um)		晶圆正面金属		基岛尺寸 (mm)	7.04 * 5.47	总线数	
切割道尺寸 (μm)		晶圆背金		电镀方式	雾锡	制图日期	
线图来源				备注			
拟制		审核		批准		文控发行章	